



中 공신부, 기초 전자부품 산업발전 행동계획(2021-2023) 발표

✓ 최근 공업정보화부가 「기초 전자부품 산업발전 행동계획(2021~2023)」을 발표했다(1.29)

- (주요목표) 2023년까지 비교우위를 갖춘 제품 경쟁력을 한층 더 강화하고 산업체인의 안전 공급 수준을 현저히 높여 스마트기기, 5G, 산업인터넷 등 중요산업을 중심으로 기초 전자부품을 발전시킴
 - 2023년까지 산업 규모를 확장하고 전자부품 총매출액을 2조 1,000억 위안 달성
 - 기술 혁신을 통해 일부 전자부품의 핵심기술을 돌파하고 무선주파수 필터(Radio Frequency Filter), 고속 커넥터 등 주요제품 특히 배치 최적화
 - 국제경쟁력을 갖춘 전자부품 업체들을 육성하고 15개 기업 영업수입 규모가 100억 위안 돌파하도록 노력
- 동 계획은 7개의 중요 업무를 제시

	구분	주요 내용
①	산업 혁신력 제고	△핵심기술 공략 △다층적 연합 혁신 시스템 구축 △지식재산권 배치 최적화
②	시장 응용 확대 능력 강화	△중점 업종의 시장 응용 지원 △산업 사슬의 심층적 협력 강화 △혁신형 제품 응용 추진
③	부대산업 인프라 강화	△핵심재료기술 돌파 △설비·기기 품질 제고 △부대산업 시스템 보안
④	산업 고도화 견인	△지능화 수준 제고 △녹색제조 홍보 △우수업체 육성
⑤	업계 질적 성장 도모	△표준화 업무 강화 △브랜드 영향 확대 △우려한 시장환경 조성
⑥	공공 플랫폼 건설 강화	△공공플랫폼 구축·분석·평가 △과학기술 서비스 플랫폼 구축 △혁신 및 창업 인큐베이터 플랫폼 구축
⑦	인재 육성 메커니즘 정비	△인재 양성 강화 △인재유치 강화 △인재 교류 추진

참고자료

- 工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023年)》
https://mp.weixin.qq.com/s/b5DnHwJHNM2pOq_lBoS1SQ